



台積公司董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2021年2月9日

台灣積體電路製造股份有限公司今(9)日召開董事會，重要決議如下：

- 一、核准 2020 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 1 兆 3,392 億 5,500 萬元，稅後淨利約為新台幣 5,178 億 9,000 萬元，每股盈餘為新台幣 19.97 元。
- 二、核准配發 2020 年第四季之每股現金股利 2.5 元，其普通股配息基準日訂定為 2021 年 6 月 23 日，除息交易日則為 2021 年 6 月 17 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2021 年 6 月 19 日起至 6 月 23 日止，停止普通股股票過戶，並於 2021 年 7 月 15 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2021 年 6 月 17 日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為 2021 年 6 月 18 日。
- 三、核准 2020 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣 695 億 637 萬元，其中員工業績獎金約新台幣 347 億 5,318 萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣 347 億 5,318 萬元將於今年七月發放。
- 四、核准資本預算約美金 117 億 9,480 萬元（約新台幣 3,242 億 9,327 萬元），內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置及升級先進製程產能；3. 建置成熟及特殊製程產能；4. 建置及升級先進封裝產能；5. 2021 年第二季研發資本預算與經常性資本預算。
- 五、核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司，實收資本額不超過日幣 186 億元（約美金 1 億 8,600 萬元），以擴展本公司之 3DIC 材料研究。
- 六、核准於不高於新台幣 1,200 億元（約美金 44 億元）之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於美金 45 億元之額度內，為本公司百分之百持有之海外子公司 TSMC Global 募集無擔保美金公司債提供保證，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。
- 七、為配合采鈺科技股份有限公司在台灣上市，核准以每股新台幣 240 元之價格，出售本公司所持有之采鈺科技普通股不超過 39,501,000 股。
- 八、核准召集 2021 年股東常會，並訂於 6 月 8 日上午九時假新竹國賓大飯店（新竹市中華路二段 188 號 10 樓）舉行，會中將改選包含六名獨立董事在內的共十名董事。
- 九、核准以下人事擢升案：
 1. 擢升本公司研發組織二奈米平台研發處資深處長葉主輝博士為副總經理；
 2. 任命林宏達博士為本公司副總經理暨資訊長。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企业公



民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2020 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 281 種製程技術，為 510 個客戶生產 1 萬 1,617 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維
企業公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com